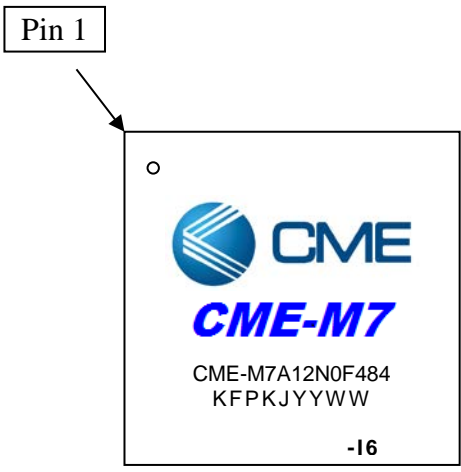







CME 器件封装说明书

公司		京微雅格（北京）科技有限公司	
封装示例：		封装说明：	
		<ol style="list-style-type: none"> 第一行：Logo  第二行：Logo  第三行：芯片名称  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CME：厂商 <input type="checkbox"/> M7：产品系列 <input type="checkbox"/> A：器件类型 <input type="checkbox"/> 12：查找表容量 <input type="checkbox"/> N0：非易失存储器容量 <input type="checkbox"/> F484：封装类型 第四行：晶圆批次号（前五位）+ 日期编码  YYWW（实际封装工作周） 例如：YY（2015年）→ 15 WW（第18周）→ 18 第五行：温度等级 + 速度等级  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> I6：工业级 + 速度等级 6 <input type="checkbox"/> 如此行空白，即为商业级，速度等级 7 	
底部封装：		底部封装说明：	
无底部封装。		无底部封装。	
备注：			
无			

联系我们：

地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 20 层

邮编：100083

电话：+86 10 6266 0566

传真：+86 10 6266 0320

E-mail: sales@capital-micro.com